

StencilMaster® STM-MICRO

GrüNiG
SignTronic

Mit Lichtgeschwindigkeit zur perfekten Siebdruckschablone!

Mit diesem Anspruch entwickeln und produzieren wir in der Schweiz eine umfangreiche Palette von **Computer-to-Screen (CtS) Anlagen** unter dem Logo **SWISS CtS TECHNOLOGY**. Die STM-MICRO basiert bereits auf der **vierten Generation** von Stencil-Master Direktbelichtungsanlagen.

Das kompakte frontbeladungs Modell ist erhältlich in zwei verschiedenen Grössen:

STM-MICRO_S bis einer max. Rahmengrösse von 900 x 900 mm

STM-MICRO_L bis einer max. Rahmengrösse von 900 x 1200 mm

Die konventionelle Siebbelichtung ist durch die grosse Anzahl von Prozessschritten sehr aufwändig, teuer und fehleranfällig. Die CtS Anlagen setzen neue Massstäbe und überzeugen mit diesen Vorteilen: Höchste Reproduzierbarkeit dank **DIGITAL SCREEN MAKING**, Filmkosten und Handling entfallen, Verbesserung der Druckqualität, höhere Produktivität, grosse Flexibilität und tiefere Schablonenkosten.

UV-Lichtquelle: Leistungsstarke **LED_Q4 (Gen6)** oder **330W CPL UV-Lampe** für eine optimale Belichtung und Durchhärtung mit nahezu allen Direktemulsionen und auf allen Geweben. Als Variante kann auch eine **UV-LED DUO Lichtquelle** angeboten werden.

Optik von ZEISS: lichtstark, verzugsfrei, stabil und hoch präzise.

Verfügbare Auflösung: 1270 dpi, 1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2), 3040 dpi (HR3).

OECU (Optical Engine Control Unit): Das Herzstück der neuen Generation. Diese Eigenentwicklung verbindet als Steuereinheit alle Prozesse für den Belichtungskopf. **DMD's (Digital Micromirror Device)** der neusten Generation werden ebenso angesteuert wie die hochpräzisen Horizontal- und Fokusachsen.

STPrint V.4: Die Bedienersoftware aus eigenem Haus erlaubt die zentrale Bedienung und Steuerung der STM Anlagen.

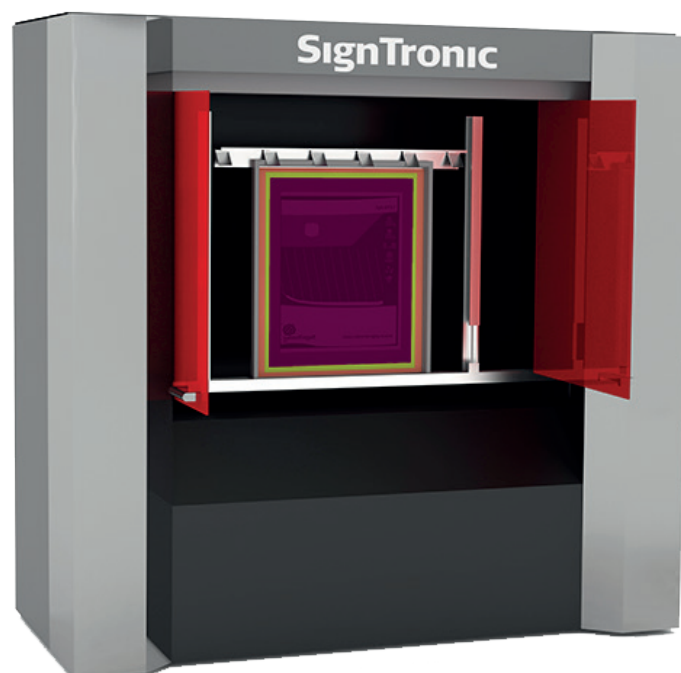
Grundkonstruktion: Diese Bauweise aus hochwertigem und massivem Stahl ist unerlässlich für eine hochwertige und präzise Direktbelichtung. Auf der Grundkonstruktion wird das Mehrachsensystem aufgebaut. Eine luftgelagerte Belichtungseinheit sorgt für vibrationsfreie Bewegungen und das einzigartige Antriebssystem arbeitet in horizontaler Richtung.

Bidirektionale Belichtung: Diese Standard-Arbeitsweise ist durch die Vor- und Rückwärtsbewegung sehr präzise und schnell.

Frontbeladung der Siebrahmen: Die STM-MICRO kann von vorne einfach und schnell beladen werden. Dies bedeutet: einfacher Zugang für den Bediener und weniger Platzbedarf für die Anlage.

Option RICB (Remote Image Control Board):

Damit wird die Belichtungsqualität einfach überwacht und beibehalten. U.a. sind folgende Kontrollen und Messungen möglich: mechanische Grundeinstellung inklusive Fokussmessung, Lichtmessung des gesamten DMD mit automatischer Maskenerstellung und Nachregelung der Lichtleistung.



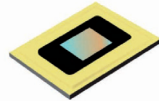
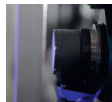
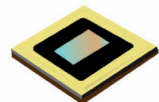
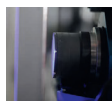
**STM
MICRO**

StencilMaster[®]

Technische Spezifikationen

Technische Daten	STM-MICRO_S	STM-MICRO_L
Höhe	1830 mm	2130 mm
Breite	1865 mm	1865 mm
Tiefe	920 mm	920 mm
Netto Gewicht	ca. 920 kg	ca. 950 kg
Max. Rahmenformat (H x B)	900 x 900 mm	1200 x 900 mm
Max. Belichtungsformat (H x B)	800 x 740 mm	1100 x 740 mm
Siebpositionierung	Gemäss Kundenspezifikationen	
Verfügbare Auflösung	1270 dpi, 1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2) oder 3040 dpi (HR3)	
UV-Lichtquelle	LED_Q4 (Gen6), High power CPL 330 W oder UV-LED DUO (385 nm / 405 nm)	
Leistungsaufnahme	~ 1100 W	
Datenschnittstelle	Ethernet 1-Gbit	
Fernwartung	In Datenschnittstelle integriert (Internetverbindung notwendig)	
Betriebssystem	Windows 11	
Technische Anforderungen		
Spannungsversorgung	208-240 VAC / 50 Hz / 16A	
Druckluftanschluss	6 bar	
Druckluftverbrauch	max. 50 l/min	
Druckluftqualität	ISO 8573-1 4.4.4	
Raumbedingungen	Gelblicht, staubfrei, vibrationsfreier Boden	
Bodenbelastung	500 kg/m2	
Umgebungstemperatur	18 - 24° C	
Luftfeuchtigkeit	25 - 75 % (rF)	
Benötigtes Datenformat	1-bit TIFF	
Optionen		
Prozesskontrolle	RICB (Remote Image Control Board)	
Masterframe M	Aufnahme für mehrere kleine Siebrahmen	
Option Z	Zusätzliche Halterung für kleine Siebrahmen	
Auflösung	1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2), 3040 dpi (HR3)	
RIP Software	SignTronic ST.Rip	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Grünig-SignTronic AG

		UV-Lichtquelle	Technologie DMD	Zeiss Optik / Auflösung
MODULAR Cts CONCEPT	UV-LED	Q4 365 / 385 / 395 / 405 nm 	XGA 0.7" – Discovery 4100 	1270 dpi  2400 dpi
		DUO 385 nm / 405 nm 		
	UV-Lampe	CPL 350 – 450 nm 	1080p 0.95" – Discovery 4100 	1609 dpi  3040 dpi
		UHP 350 – 450 nm 		